(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2007 年8 月23 日 (23.08.2007)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2007/094129 A1

(51) 国際特許分類:
H05K 3/46 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2007/000069

(22) 国際出願日: 2007 年2 月8 日 (08.02.2007)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2006-035120 2006 年2 月13 日 (13.02.2006) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友ベークライト株式会社 (SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川２丁目５番８号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 近藤正芳 (KONDO, Masayoshi) [JP/JP]; 〒0118510 秋田県秋田市土崎港相染町字中島下２７－４ 秋田住友ベーク株式会社内 Akita (JP). 小宮谷壽郎 (KOMIYATANI, Toshio) [JP/JP]; 〒0118510 秋田県秋田市土崎港相染町字中島下２７－４ 秋田住友ベーク株式会社内 Akita (JP).

(74) 代理人: 速水進治 (HAYAMI, Shinji); 〒1500021 東京都渋谷区恵比寿西２－１７－１６代官山ＴＫビル１階 Tokyo (JP).

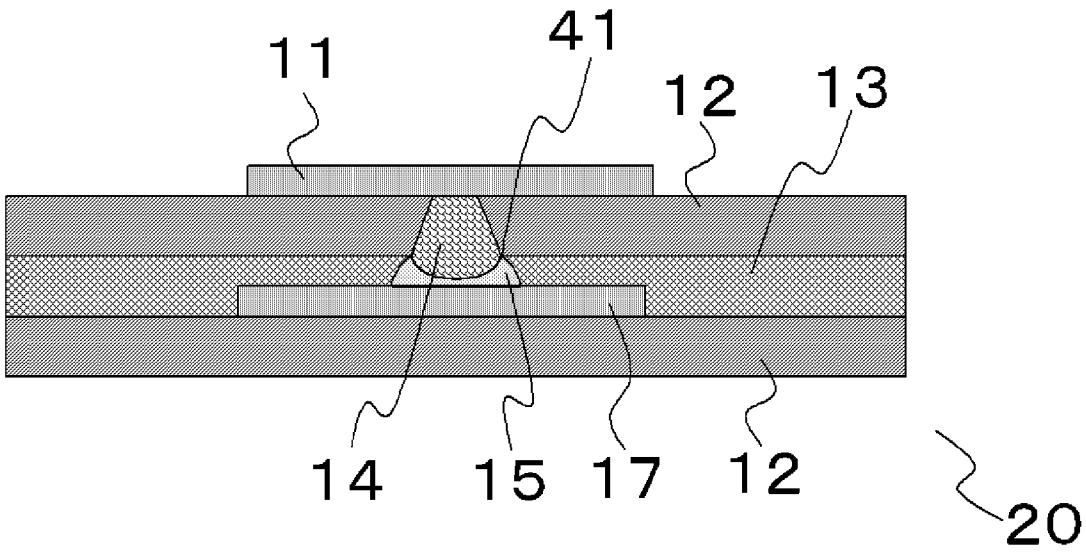
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,

[続葉有]

(54) **Title:** CIRCUIT BOARD MANUFACTURING METHOD AND CIRCUIT BOARD

(54) **発明の名称:** 回路基板の製造方法および回路基板



(57) **Abstract:** In a circuit board manufacturing method, a first substrate having a conductor post and a second substrate having a conductor pad for receiving the conductor post are laminated through an interlayer adhesive, and the conductor post and the conductor pad are electrically connected. The method includes a first step of bonding the conductor pad with the conductor post by thermo-compression under prescribed first conditions, in a status where the first substrate and the second substrate are arranged to have the conductor pad face the conductor post through the interlayer adhesive; a step of performing thermocompression to the first substrate and the second substrate under prescribed second conditions, in a status where the conductor pad is bonded with the conductor post; and a step of performing thermocompression to the first substrate and the second substrate under prescribed third conditions, in the status where the conductor pad is bonded with the conductor post. The first, second and third conditions are different from each other.

[続葉有]

WO 2007/094129 A1

CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約: 導体ポストを有する第一の基板と、前記導体ポストを受ける導体パッドを有する第二の基板とを層間接着剤を介して積層し、前記導体ポストと前記導体パッドとを電気的に接続する回路基板の製造方法であって、前記第一の基板と前記第二の基板とを、前記層間接着剤を介して、前記導体パッドが前記導体ポストと対向するように配置した状態で、所定の第一の条件で熱圧着して、前記導体パッドと前記導体ポストを接合する第一の工程と、前記導体パッドと前記導体ポストが接合した状態で、前記第一の基板と前記第二の基板とを所定の第二の条件で熱圧着する工程と、前記導体パッドと前記導体ポストが接合した状態で、前記第一の基板と前記第二の基板とを所定の第三の条件で熱圧着する工程とを含み、前記第一、第二および第三の条件がそれぞれ異なることを特徴とする製造方法が提供される。